



第2回 異種材料接合技術研究会 (全3回)

主催：(公財)科学技術交流財団
後援：名古屋大学協力会

協力：愛知工研協会

昨今、異種材料の接合技術は自動車や電子、電機分野で積極的に利用されています。従来では困難とされた異種材料の接合技術の革新は目覚ましいものがあり、新たな材料を組み合わせることで、製品の軽量化や機能・性能の向上、コスト削減に寄与するものと期待されています。

当財団では企業の方々の新事業創出、新商品開発などに役立ていただくことを目的とし、異種材料接合の最新の状況について、専門家を招聘してご講演いただく研究会を全3回の予定で開催します。是非ご参加ください。

《第2回》

日時：平成31年1月10日(木)

13:30~16:30

場所：ウインクあいち 1201会議室

(愛知県産業労働センター)

名古屋市中村区名駅4-4-38

※応募多数の場合は、締切日前に受付を終了させていただきます(定員：80名)。



(JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口から ミッドランドスクエア方面 徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分
※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア、マルケイ観光ビル、名古屋クロスコートタワーを経由 徒歩8分

《プログラム》

13:30~14:40 「次世代パワー半導体のための異種材接合技術」

講師 大阪大学 産業科学研究所 所長 菅沼 克昭 氏

SiC がいよいよ新世代のパワー半導体として実用化開始された。SiC 実用により、効率が上昇するだけでなく高周波化とパワー密度増加が可能になり、電力変換機器の小型化が魅力となる。一方で、デバイスの駆動温度上昇が余儀なくされ、厳しい環境でも信頼性高く実装することが必要になっている。DBC、DBA等の絶縁基板へのダイ接合をはじめとし、様々な異相界面をどのように形成し実用化するかについて現状を紹介する。

14:40~14:50 休憩

14:50~16:00 「さまざまな異材樹脂接合を可能にする新規接合技術『AKI-Lock®』」

講師 ポリプラスティクス株式会社 研究開発本部
テクニカルソリューションセンター 見置 高士 氏

弊社では、1次成形品内のガラス繊維を物理アンカーとして利用した新しい異材接合技術「AKI-Lock®」を開発した。溶着でもなく接着でもない当技術は、材料の制約も少なく、従来では難しかったさまざまな異材の組合せで強固な接合が可能である。本講演では、AKI-Lock®の技術内容と接合事例等を紹介する。

16:00~16:30 名刺交換会(自由参加)

